

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

上海骄成超声波技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他
参与单位名称及人员姓名	中邮基金、众惠财产、华安资管、东吴证券
会议时间	2026 年 7 月 30 日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：孙凯
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司情况介绍 公司副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯先生向与会投资者介绍了公司核心超声波技术及应用情况。 二、问答环节 Q1、超声技术与其他连接方式相比优势有哪些？ A1、在焊接领域，超声技术在金属焊接方面具有焊接效率高、焊接后导电性好、不需任何助焊剂、气体、焊料等技术优势，在新能源电池多层极耳焊接环节中超声波焊接拥有难以替代的优势。在检测领域，对于工件内部的平面型缺陷或界面缺陷，如裂纹、未熔合、界面分层等情况，超声波的反射特性优势明显，超声波在界面会大量反射，产生极其强烈的回波信号，利用界面声阻抗差异，超声波检测技术可精准、无损伤地探测出半导体晶圆、2.5D/3D 封装、芯片贴装等内部缺陷，在上述领

	域中超声波检测亦拥有难以替代的优势。 Q2、请问在锂电领域超声技术有哪些新应用？ A2、在新能源电池领域，公司围绕下游客户需求持续开展工艺优化与产品迭代，成功开发了双峰焊机、新型焊机以及多种配套在线监控等产品。依托相关产品，公司积极把握下游新能源电池行业产线新建、存量产线升级的市场机会，进一步巩固公司在该领域的市场竞争优势。 Q3、公司半导体领域业务有何突破或展望？ A3、在功率半导体领域，公司有超声波端子焊机、超声波 PIN 针焊机、超声波键合机、超声波扫描显微镜等全工序超声波解决方案，并均已实现批量出货。在半导体先进封装领域，公司可应用于半导体晶圆级封装、2.5D/3D 封装、面板级封装等产品检测的先进超声波扫描显微镜，成功获得国内头部半导体存储厂商正式订单；超声波固晶机已获得客户正式订单，产品验证进展顺利。公司紧跟下游半导体产业升级需求与技术发展趋势，持续完善产品矩阵，深化与下游客户合作，推动半导体业务可持续发展。 Q4、公司配件业务都有哪些？以及营收占比情况？ A4、公司配件产品包括焊头、底模、裁刀、劈刀、焊嘴、发生器、换能器等。2025 年度公司配件业务收入 2.60 亿元，占主营业务收入比例约为 33%，配件业务持续发展，逐步成为公司营收的重要构成。 Q5、公司产品中的核心器件自研情况如何？ A5、公司拥有自主生产超声系统核心零部件的能力，在超声应用领域拥有专业的团队和丰富的经验积累，相比竞争对手公司在技术创新、人才资源等方面积累了较强的竞争优势。公司通过与知名客户保持紧密合作，以潜在市场需求和客户实际需求为导向，对行业未来发展方向和技术进行预判，积极布局开发新技术、新产品和应用新领域，解决行业内技术难点和痛点，
--	---

	不断提升公司核心竞争力。 Q6、超声设备应用范围很广，还有哪些潜在应用？ A6、依托在超声波领域深厚的研发积淀及丰富的行业应用经验，公司紧抓下游新能源电池等行业产线新建、存量产线升级的市场机会，持续巩固公司在该领域的市场竞争优势。随着下游新能源汽车、半导体、航空航天等行业快速发展及技术迭代更新，超声技术的应用场景不断拓展。公司立足自有底层超声核心技术，紧跟下游行业发展趋势，重点围绕新能源电池、半导体、线束连接器等领域进行产品布局与技术创新，积极把握下游新能源、半导体、医疗及新兴行业等领域的市场机遇，促进公司业务实现长远发展。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 7 月 30 日